

上海聚跃检测技术有限公司

地址: 上海市张东路 1388 号 2 幢 101 室

序号	产品/产品类别	项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	测量容量	备注
		序号	名称				
1	电工电子产品 /电子半导体 产品	1	外观目检	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 2009.2	只测: 放大倍数 3 倍 ~50 倍		
		2	开封实验	军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB-4027B-2021 中 1103 中 2.6.2			

		3	扫描电子显微镜 SEM 检查	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 2018.2		分辨率: 1nm 平面可移动的最大尺寸: X/Y:50*50mm, Z:1.5_30mm	
		4	去层试验	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 5003 中 3.3.3		样品尺寸不能超过 8 寸	
		5	电性验证试验	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 5003 中 3.2.3.3.2.4		量程: ±9v 500mA 分辨率 2uA	
		6	红外扫描试验	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 5003 中 3.4 (d)		波长: 1300nm,检测电压范围: 0~20v,检测电流能力: 0-100mA	
		7	剖面分析试验	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 5003 中 3.3.2			

		8	探针试验	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 5003 中 3.2.12			
		9	电子束显微分析	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 5003 中 3.4.e		平面 1um,深度 2um	

